

<2019年度『市場・業界及び技術動向セミナー』開催要領>

1. 開催日時：2020年3月19日（木）13:30～17:00（受付開始13:00）
2. 会場： 投資育成ビル 7F 701号室  
（渋谷区渋谷3-29-22）（03-5469-5870）  
（JR渋谷駅 新南出口より右手方向に徒歩2分）
3. 主催： 一般社団法人 日本半導体商社協会(DAFS) セミナー委員会  
後援： 経済産業省、一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)、  
一般社団法人 日本電子デバイス産業協会 (NEDIA)

4. 演題・講師／略歴・講演要旨：

・第1部（13:40～15:10）（90分）

演題： 「大型ディスプレイ市場動向～技術とアプリケーション～」

講師： IHS マークイットジャパン合同会社

大型業務用ディスプレイ & モニター市場担当ディレクター

氷室 英利 氏

講演要旨

大型ディスプレイ市場は、LCDを中心に拡大を続けていますが、近年では成長率はやや鈍化傾向となっています。一方、10.5世代などの超大型ガラスを使用した工場が中国で多数建設され、一部稼働も始まり、業界では在庫長期化の懸念が増大する中で、ディスプレイに付加価値をつけていこうという姿勢が明確になりつつあります。各メーカー、セットブランドともディスプレイ事業をLCDからOLEDあるいは直視型狭ピッチLED、更にはミニ、マイクロLEDへ拡大を図っており、デバイス間の競合、棲み分けも実際始まりました。本セッションでは、各ディスプレイデバイスとそれを使用したセット、さらに要件と技術トレンド、最終市場における用途の現状について、最新の市場調査データをもとに解説します。

講師略歴

1985年 東京理科大学卒業。同年日本電気入社。ノートパソコン、液晶モニター的设计開発を始め、液晶パネル資材調達、海外OEM技術管理、先行技術調査業務など歴任。海外駐在時（アメリカ・シカゴ）、DELL初のLCDモニター受注。NASAに初の液晶モニター納入など。

2007年 ディスプレイサーチ入社。主にデジタルサイネージ、デスクトップモニター、医療用モニターなど大型B2Bディスプレイセット市場の調査を担当。IHS Markitにて現職。

（休憩：20分）

・第2部 (15:30~17:00) (90分)

演題： 『AI・IoT社会へ貢献する3次元集積実装技術と国家プロジェクトにおける研究開発動向』

講師： 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 ナノエレクトロニクス研究部門  
3D集積システムグループ 研究グループ長  
菊地 克弥 氏

講演要旨

近年の AI・IoT 社会に必要な電子デバイスでは、小型化、低消費電力化、高性能化が要求されている。そのため、シリコン貫通電極(TSV)を用いて半導体デバイスを縦方向に積層する3次元集積実装技術は、メモリ積層のような単一機能のデバイスの3次元集積のみならず、メモリやロジックなどの複数機能を3次元集積する応用が期待されている。今回は、AI・IoT社会のさらなる発展に向けて、車載半導体、ビッグデータ処理などへの応用を想定した3次元集積実装技術の研究開発とその国家プロジェクトについて紹介する。

講師略歴

2001年埼玉大学大学院博士後期課程情報数理科学専攻修了。博士(工学)。

同年、産業技術総合研究所エレクトロニクス研究部門高密度SIグループ勤務。

以降、半導体LSI実装技術における3次元集積実装技術をはじめとする次世代の電子回路高密度実装技術、超高速・高周波回路実装技術、およびその計測・評価技術の研究開発等に従事。

2015年同ナノエレクトロニクス研究部門3D集積システムグループ 研究グループ長。

5. 受講対象者：DAFS 会員及び関連団体会員 (JEITA、NEDIA、SSIS 等)、他エレクトロニクス分野の業務に従事されている方、または同分野に関心をお持ちの方であればどなたでも受講可能です。

6. 参加費(消費税込み)： 10,000円/1人 (当日現金支払い、領収書発行)

7. 受講申し込み: DAFS 会員以外の方は DAFS ホームページの「お問い合わせ」ページより、お申し込みください。会場の都合により定員(50名)になり次第締め切りますのでお早めにお申し込みください。

申し込み締め切りは2月25日(火)といたしますが、会場の都合により定員(50名)に達し次第締め切りますのでお早めにお申し込みください。

以上